

TMG 225

TMG 225 用於酯化和酯交換反應，添加量 0.01-1%，催化劑很容易溶於酯類，反應溫度 適用於 80-240°C。

TMG 225 相比於其它類型的 DBTL 更有優勢，因為它有一個更高的錫含量和更高的催化活性。

TMG 225 適用於矽樹脂和矽烷的縮聚，特別適用於 RTV 矽樹脂的生產。

儲存

TMG 225 可在原包裝中至少儲存 1 年。

包裝

25kg 塑膠桶裝

化學性質

分子式	【(C ₄ H ₉) ₂ Sn(OOC-C ₁₁ H ₂₃)】 ₂ O
CAS 號	3669-02-1
錫含量	≥25.3%

物理性質

外觀	淺黃色液體
粘度	Approx.300mPas
密度 (20°C)	Approx.1.15g/ml

安全建議

有關資訊：

- 按化學品運輸規則的分類及標籤
- 儲存和操作時的保護措施
- 事故和著火時的措施
- 毒性和生態效應 都在安全資料表中列出